

KARTA TECHNICZNA

▷ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR® AL GK

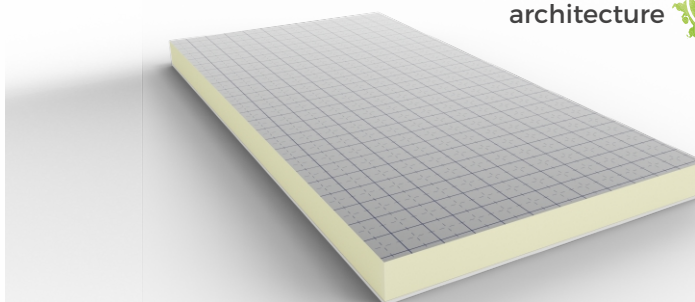


termPIR®
płyty izolacyjne

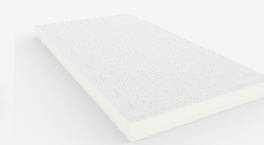
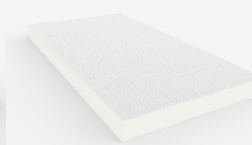
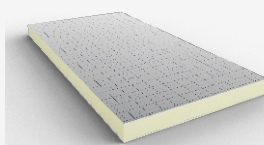
Opis płyty

Kompozytowe płyty izolacyjne **termPIR® AL GK** składają się z płyty termPIR® z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie gazoszczelną okładziną warstwową na bazie papieru oraz aluminium oraz z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm. Pomiędzy płytą z okładziną aluminiową, a płytą g-k znajduje się warstwa adhezyjna.

Green
architecture



Wizualizacja płyt z dostępnymi frezami



Dostępne frezy

FIT (frez płaski)

LAP (frez schodkowy)

TAG (pióro-wpust)

Zastosowanie płyt termPIR® AL GK w energooszczędnych budynkach

Budynki:	Przeznaczenie płyty:	
▷ jednorodzinne, wielorodzinne	▷ dachy skośne w układzie nakrokwiowym	
▷ jednorodzinne	▷ dachy skośne w układzie podkrokwiowym	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ dachy płaskie - stropodachy, tarasy - montowane mechanicznie	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ dachy płaskie - stropodachy, tarasy - system klejony	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany zewnętrzne trójwarstwowe	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany zewnętrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany piwnic i fundamentów	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany działowe	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ stropy międzykondygnacyjne	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ podłoga na gruncie	
▷ inwentarskie, przemysłowe	▷ sufity podwieszone - zmywalne	
▷ istniejące, zabytkowe, klatki schodowe	▷ docieplenie ścian od wewnątrz	
▷ prefabrykowane odporne na korozję betonu	▷ ściany z prefabrykatów	

Legenda

- płyta zalecana do użycia

- płyta możliwa do użycia

Instrukcje

Płyty montować za pomocą klejenia z dodatkowym mocowaniem mechanicznym (za pomocą wrętów typowych jak do płyty g-k, o długości dobranej do grubości płyty i typu podłoża). Klej dobrać do rodzaju podłoża i okładziny płyty - zalecany klej poliuretanowy lub klej do styropianu. Zapoznać się ze specyfikacją kleju. Zalecana temp. montażu: 5 - 20°C. Zapewnić stabilność podłoża. Przed montażem podłoże oczyścić i (opcjonalnie) zagruntować. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy płytami g-k po montażu płyty zafugowuje się i zabezpiecza tak jak typową płytę g-k. Zostawić przerwę pomiędzy podłogą a płytą oraz zabezpieczyć przez podciąganiem wilgoci. Płyty przechowywać w warunkach suchych. Płyty nie są elementem nośnym.

KARTA TECHNICZNA

▶ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR® AL GK



termPIR®
płyty izolacyjne

Właściwości		Wartości / Klasy											
Długość / Szerokość		2,6 m (±10 mm) / 1,2 m (±7,5 mm)											
Grubość całkowita (d _N + 12,5 mm)		grubość d _N * płyty termPIR® z okładziną oraz grubość płyty karton-gips 12,5 mm											
Wspł. przewodzenia ciepła, λ _D dla d _N * = 25 mm /+ 12,5 mm:		0,022 [W/m·K]											
Opór cieplny, R _D dla d _N * = 25 mm /+ 12,5 mm:		1,15 [W/m²·K]											
Wspł. przewodzenia ciepła, λ _D dla d _N * = 20 - 250 mm /+ 12,5 mm:		0,022 [W/m·K]											
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R _D [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm /+12 mm:	20	0,90	30	1,35	40	1,85	50	2,30	60	2,75		
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R _D [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm /+12 mm:	70	3,25	80	3,70	90	4,15	100	4,65	110	5,10		
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R _D [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm /+12 mm:	120	5,55	130	6,05	140	6,50	150	6,95	160	7,45		
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R _D [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm /+12 mm:	170	7,90	180	8,35	190	8,85	200	9,30	210	9,75		
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R _D [m²·K/W] dla d _N * = 20 - 250 mm /+12 mm:	220	10,20	230	10,70	240	11,10	250	11,60				
Reakcja na ogień (w zastosowaniu końcowym) Rozprzestrzenianie ognia		Klasa B-s1,d0 "nierozprzestrzeniający ognia" Dotyczy płyt termPIR® AL GK o grubość warstwy PIR 20-140 mm + 12,5 mm g-k. Podłoże: Każdy rodzaj podłoża niepalnego i drewnopodobnego. Mocowanie za pomocą klejenia (w tym również klejami palnymi). Możliwe mocowanie mechaniczne. Szczegóły w klasyfikacji.											

* Parametry cieplne dotyczą termoizolacyjnego rdzenia PIR wraz z okładzinami.

W obliczeniach nie uwzględniono oporu cieplnego płyty gipsowo-kartonowej oraz oporu warstwy adhezyjnej.

Parametry płyty termPIR® z okładziną aluminiową

Gęstość rdzenia PIR	30 kg/m³		
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu, σ_{10}	dla ($20 \leq d_N < 30$ mm): ≥ 120 kPa , CS(10/Y)120	dla ($30 \leq d_N \leq 250$ mm): ≥ 150 kPa , CS(10/Y)150	

Parametry płyty karton-gips (na podstawie deklaracji producenta)

Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0
Przewodność cieplna (dla grubości 12,5 mm)	0,25 [W/m·K]